

## 第二玻璃基板与 TGV 技术大会

随着摩尔定律逼近物理极限，先进封装成为延续半导体性能提升的关键路径。玻璃基板凭借其高密度互连、优异高频特性、低成本面板级工艺等优势，正在颠覆传统有机基板（ABF/BT）和硅中介层的市场格局。英特尔、三星、台积电等巨头已明确将玻璃基板纳入技术路线图，预计 2030 年全球市场规模突破百亿美元

玻璃通孔技术（TGV）是玻璃基板的核心技术之一，与硅通孔（TSV）相比，具有低成本、大尺寸超薄玻璃衬底易获取、高频电学性能优异等特点。玻璃基板可进行大尺寸生产，具有超薄加工的可能性，基于玻璃通孔（TGV）的转接板工艺在微波系统集成领域中的应用越来越为人们所关注。多年以来，业界及学界许多研究工作都致力于研发低成本、快速可规模化量产的成孔技术。

中国作为全球最大的半导体消费国和封装产业聚集地，亟需在玻璃基板这一战略领域突破技术瓶颈、构建本土供应链。为强化行业信息交流，中粉会展计划于 2026 年 7 月 3 日在合肥举办**第二玻璃基板与 TGV 技术大会**。本次论坛将汇聚顶尖专家、产业链领袖及政策制定者，共同探讨技术突破路径与产业化机遇。

会议热诚欢迎行业专家、学者、技术人员、企业界代表出席，同时欢迎公司、企事业单位展示技术成果，洽谈产、学、研合作。

### 时间

2026 年 7 月 3 日 （7 月 2 日签到）

### 地点

合肥 新站利港喜来登酒店

安徽省合肥市 瑶海区铜陵北路 1666 号

### 主办单位



## 媒体支持



## 会议主题

### 一、TGV（玻璃通孔）核心技术攻坚

1、高深宽比 TGV 制备工艺：激光诱导蚀刻、激光烧蚀、等离子刻蚀等技术路线的关键挑战与解决方案

2、TGV 金属化与填充技术：无空洞、高可靠性填充，种子层沉积，电镀工艺优化

3、TGV 可靠性与检测

### 二、玻璃基板在 AI 与高性能计算（HPC）中的应用

1、大尺寸、高密度封装解决方案

2、共封装光学（CPO）与玻璃基板的融合

3、扇出面板级封装（FOPLP）技术

### 三、玻璃基板材料与工艺创新

1、新型玻璃材料开发，超薄与大尺寸玻璃基板制造

2、多层玻璃堆叠与键合技术

3、关键设备与材料国产化：聚焦 TGV 加工设备（激光钻孔、电镀设备）、特种玻璃、光刻胶等关键环节的国产化替代

## 二、特色活动

大会征集参会企业相关技术合作、产品采购，工艺方案等需求进行现场采配活动，相关信息将进行展板展示，提高现场沟通交流效率！

征集内容包含但不限于以下几点：

1、玻璃基板行业投资、融资需求

2、科研成果转化

3、产品工艺问题解决方案

4、原料、设备、仪器采购需求

.....

## 会议费用

2800 元/人

费用包含：会议资料费、会议餐费、茶歇、会务服务等费用，不含住宿

## 收款账户

户名	山东中粉会展服务有限公司
开户行	中国银行股份有限公司临沂北城支行
账号	233841636876

## 会务组

联系人：任海鑫

联系方式：18660985530（微信同号）

